

113 年度
經濟部產業發展署
半導體產業人才創能加值計畫
人才多元培訓模式入選結果
【第一梯次】

編號	申請單位	技術主題
1	財團法人台灣永續能源研究基金會	客製化企業永續發展與實務演練
2	卜踐	數位轉型-工程師戰力指標系統架構建置與導入
3	台灣檢驗科技股份有限公司	先進汽車電子半導體 IC 安全設計 SC-AFSP
4	三建資訊有限公司	高導熱封裝材料技術研析
5	三建資訊有限公司	對應最新封裝技術的散熱設計進化
6	國立成功大學/李順裕教授	三角積分調變器設計與生醫訊號擷取系統應用